

2023年9月6日

報道関係各位

PALTEK SOLUTION SUPPLIER
PALTEK
プレスリリース
株式会社 PALTEK

**環境保全と効率性を両立！PALTEK が
「国際物流総合展 2023 第 3 回 INNOVATION EXPO」で
Ranpak 紙梱包資材を展示～紙が物流コストと環境問題を変えていく～**

株式会社 PALTEK（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田 光治、以下 PALTEK）は、2023年9月13日（水）から9月15日（金）まで、東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展 2023 第 3 回 INNOVATION EXPO」に出展し、「紙が物流コストと環境問題を変えていく」をテーマに、Ranpak 株式会社（以下 Ranpak）の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進について提案します。

ここ数年の生活様式の大幅な変化により、EC・物流業界は大きく様変わりしています。ネットショッピングの利用が継続的に拡大するなか物流量は大幅に増加し、EC 事業者や物流事業者では出荷作業のオートメーション化などの物流生産性向上が求められています。また、世界的な「脱プラスチック」の流れは加速しており、プラスチック系の梱包資材の使用を控える動きなども顕著になっています。



展示会出展ブースイメージ

PALTEK の提供する Ranpak の紙梱包資材はプラスチック製品の梱包資材の置き換えが可能のため、食品や雑貨・日用品を扱う通信販売や実店舗での採用に加え、電子機器などの精密機器や医薬品など、さまざまな商品の緩衝材として採用が広がっています。Ranpak の紙梱包資材は、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小、梱包作業の高速化による労働コストの削減などのトータルコストの大幅な削減が可能となります。

「国際物流総合展 2023 第3回 INNOVATION EXPO」は、ロジスティクス・物流に関わるあらゆる技術、知識、情報を集約、フル活用し、経営の変革を促進することを目的とした展示会です。

PALTEK ブースでは、次世代緩衝材システムの実演やラッピングシステム、配送箱と製品とのすき間を高速で埋める高速すき間埋めシステムなどを展示し、Ranpak の紙梱包資材活用による物流コストの低減と脱プラスチックの促進を提案します。また、コールドチェーン向け紙梱包ソリューションについても梱包見本を展示します。

■ 展示会の概要

展示会名 : 「国際物流総合展2023 第3回 INNOVATION EXPO」



INNOVATION
The 3rd **EXPO**

開催日時 : 2023年9月13日(水)から9月15日(金) 10:00~17:00

会場 : 東京ビッグサイト 西1-4ホール (〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1)
PALTEKブースは、1 A-04

主催 : 一般社団法人 日本産業機械工業会、一般社団法人 日本産業車両協会、一般社団法人 日本パレット協会、一般社団法人 日本運搬車両機器協会、一般社団法人 日本物流システム機器協会、公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会、一般社団法人 日本能率協会

展示会URL : <https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ie/index.html>

来場事前 : <https://www.logistech-online.com/jp/registration.php>

登録URL (ご来場の際には事前登録が必要となります。)

■ 主な出展内容

・次世代緩衝材システム : PadPak®Guardian

「PadPak®Guardian」は、梱包速度の向上によるコスト削減に加え、C字型に折り畳まれたペーパーを採用したことにより、緩衝材の補充作業など使い勝手のよい操作性を提供します。

これにより、電子・電気部品から自動車用スペアパーツや産業機械設備などの重量のある商品まで、幅広い商品の梱包ニーズに応えます。



次世代緩衝材システム
「PadPak®Guardian」

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/padpak/padpak_guardian/index.html

・高速すき間埋めシステム：FillPak®

「FillPak®」は、配送箱と製品とのすき間を高速で埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/fillpak/index.html>



高速すき間埋めシステム「FillPak®」

・ラッピングシステム：Geami WrapPak®

「Geami WrapPak®」は、特許を取得したダイカット（切り込み）入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/geami_wrappak/index.html



ラッピングシステム「Geami WrapPak®」

・コールドチェーン向け紙梱包ソリューション

生鮮食品や冷凍食品、医薬品などを生産・輸送・消費の過程で一貫して低温・冷蔵・冷凍の状態を保ったまま流通させる仕組みであるコールドチェーンでは品質の劣化を防ぐために低温管理が求められます。

低温状態を維持するためには、熱伝導率の低い素材である紙を緩衝材として梱包物内の隙間を埋めることで、梱包物内の空気循環を少なくし、保冷効果を持続することができます。

Ranpakの紙緩衝材をコールドチェーンに使用することにより、今と同じ輸送温度帯品質を保持しながら最大72時間、大切な商品の設定温度帯を保持して輸送することが可能なため、品質を重要視する冷凍食品やワクチンなどの医薬品の梱包にも最適です。

詳細は、以下URLよりご確認ください。

<https://www.paltek.co.jp/solution/ranpak/products/coldchain/index.html>



コールドチェーン向け紙梱包ソリューション

■ Ranpak株式会社について

Ranpakは世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に1972年に設立され、世界に230社以上の代理店、400箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包資材・システムメーカーです。40年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を400以上有し、世界で

6万社のユーザーに提供しております。Ranpak BVは、欧州およびアジアに100以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリスなど）の成熟市場、東ヨーロッパ（ポーランド、スロバキア、トルコ）の発展途上市場、およびアジア太平洋（オーストラリア、日本、シンガポールなど）など、世界中に拠点があります。

Ranpak に関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

■株式会社PALTEKについて

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェア等の設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。なお、2021年6月よりPALTEKは株式会社レスターホールディングスのグループ企業となりました。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1：ニュースリリースに関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	広報担当 柴崎、寺田
メールアドレス	pr@paltek.co.jp
所在地	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話	03-5479-7032

2：本展示会に関するお問い合わせ

会社名	株式会社 PALTEK
担当者	「国際物流総合展 2023 第 3 回 INNOVATION EXPO」展示会担当者
メールアドレス	info_pal@paltek.co.jp
所在地	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 10 番 9 号レスタービルディング
電話	03-5479-7020